

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

798

ML4

Erstellt:

Bierlein, Tobias

Kunde:

Datum:

04.06.2018



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	102		2	
A-RS-FR4-ML-0.10mm-018+018-TG150-HF	50200646	18	L2	3	
		100			
		18	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	102		4	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	5	

Dicke nach Verpressen

B00: 390 µm Tol+: 50 µm Tol-: 50 µm Dmax: 440 µm Dmin: 340 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 500 µm Tol+: 50 µm Tol-: 50 µm Dmax: 550 µm Dmin: 450 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 376 µm

Version 1.2.18.12

© Würth Elektronik